

证券代码：002129

证券简称：中环股份

公告编号：2020-71

天津中环半导体股份有限公司 关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天津中环半导体股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年7月23日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金211,091.00万元。现将有关事项公告如下：

一、募集资金及投资项目情况概述

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津中环半导体股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1293号）文核准，公司非公开发行人民币普通股247,770,069股，发行价格为20.18元/股。本次募集资金总额4,999,999,992.42元，扣除本次发行费用（不含增值税）86,510,380.33元后，募集资金净额为4,913,489,612.09元。上述募集资金到位情况已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（CAC证验字[2020]0141号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

根据公司2020年2月20日公告《2019年非公开发行A股股票预案（修订稿）》，本次发行募集资金总额不超过人民币500,000.00万元，扣除发行费用后的净额拟投资于以下项目：

序号	募集资金用途	投资总额 (万元)	拟使用募集资金 (万元)
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	570,717.17	450,000.00
2	补充流动资金	50,000.00	50,000.00
合计		620,717.17	500,000.00

为及时把握市场机遇，在募集资金到位前，公司以自筹资金先行用于上述项目的建设，募集资金到位后，公司将以募集资金对前期投入的资金进行置换。

二、募集资金投入和置换情况

截至2020年7月20日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为

211,091.00 万元，其中可置换金额合计为人民币 211,091.00 万元，具体投资情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	自筹资金预先投入	拟置换金额
1	集成电路用8-12英寸半导体硅片之生产线项目	211,091.00	211,091.00
	合计	211,091.00	211,091.00

上述预先投入的自筹资金金额已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）《募集资金置换鉴证报告》（CAC 证专字[2020]0458 号）予以确认。

为保障募集资金投资项目的顺利进行，提高募集资金利用效率，公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。

以募集资金置换上述预先投入的自筹资金，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。

三、董事会审议情况

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。

四、独立董事意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《独立董事工作制度》和公司《募集资金管理办法》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司用募集资金置换已投入募集资金项目投资情况进行了认真、审慎的核查。独立董事一致同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。

五、监事会意见

公司于 2020 年 7 月 23 日召开第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于用募集资金置换已投入募集资金项目投资的议案》，监事会全体成员一致认为：公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，符合公司的发展需要，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。同意用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 211,091.00 万元。

六、保荐机构核查意见

保荐机构认为，中环股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的行为履行了必要的决策程序，符合相关规定的要求。

保荐机构对中环股份本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金无异议。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第四十四次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十六次会议决议；
- 3、独立董事关于相关事项的独立意见；
- 4、中审华会计师事务所《募集资金置换鉴证报告》（CAC 证专字[2020]0458 号）；
- 5、平安证券股份有限公司《关于天津中环半导体股份有限公司用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的核查意见》。

特此公告

天津中环半导体股份有限公司董事会

2020年7月23日